

证券代码：002156 证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券：王传晟；和谐汇一：范如铭
时间	2025 年 5 月 20 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司概况 通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。 公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。2024 年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆科技 26%股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于 2025 年 2 月 13 日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。 目前，公司在南通拥有 3 个生产基地，同时，在苏州、槟城、合肥、厦门也积极进行了生产布局，产能方面已形成多点开花的局面，有利于公司就近更好地服务客户，争取更多地方资源。同

时，先进封装产能的大幅提升，为公司带来更为明显的规模优势。

财务数据方面，公司 2021 年、2022 年和 2023 年和 2024 年分别实现营收 158.12 亿元、214.29 亿元、222.69 亿元和 238.82 亿元。公司 2021 年、2022 年和 2023 年和 2024 年的归母净利润分别为 9.57 亿元、5.02 亿元、1.69 亿元和 6.78 亿元。

二、行业情况

2024 年，半导体行业逐步进入周期上行阶段，在全球经济逐步复苏与数字化转型加速的大背景下，半导体作为现代科技的核心基石，迎来了增长与变革，半导体行业在消费电子复苏和人工智能的创新共振中，逐步向好。消费电子领域的回暖，使得智能手机、平板电脑等设备的出货量逐步回升，拉动半导体市场规模扩张。而人工智能领域对算力的渴求，进一步拓宽了半导体行业的发展边界，为其持续增长注入源源不断的动力。

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的统计，2024 年全球半导体销售额达到 6,276 亿美元，相较于 2023 年的 5,268 亿美元，增长 19.1%，年销售额首次突破 6,000 亿美元大关。

2024 年存储器、逻辑芯片、微处理器实现正增长，其中存储器产品、高性能 DRAM 产品及服务器 SSD（固态硬盘）受人工智能大模型需求刺激销量实现大幅度提升，存储器产品增长率达到 75.6%，成为半导体产品中增速最大的类别。

2024 年，全球半导体封测行业在经历了前几年的供应链波动后，逐步进入稳定增长阶段。随着人工智能、高性能计算、5G 通信、汽车电子等领域的需求驱动，封测行业作为半导体产业链的关键环节，市场规模持续扩大。根据 Gartner 于 2024 年 12 月发布的报告，2024 年全球集成电路封测市场规模预计达到 820 亿美元，同比增长 7.8%。

2025 年，人工智能大模型发展将继续发酵，持续带动高性能芯片应用，手机、电脑等消费市场有望回暖，机器人领域创新将带动其余集成电路产品的销售。市场调研机构 Counterpoint 认为，AI 芯片将成为核心战场，AI 计算需求推动 GPU 需求，预计未来几年存储芯片、数据中心、边缘计算仍将高增长。

三、2024 年及 2025 年第一季度业绩情况

2024 年，公司实现营业收入 238.82 亿元，同比增长 7.24%；公司实现归属于母公司股东的净利润 6.78 亿元，同比增长

299.90%。2025 年第一季度，公司实现营业收入 60.92 亿元，同比增长 15.34%；公司实现归属于母公司股东的净利润 1.01 亿元，同比增长 2.94%。其他 2024 年度及 2025 年第一季度详细情况，可以关注公司对外披露的公告。

四、投资者关注的主要问题

问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

问题 2：介绍一下公司各类业务经营情况？

回复：2024 年，半导体行业逐步进入周期上行阶段，公司抓住通讯终端复苏机遇，在 SOC、WIFI、PMIC、显示驱动等核心领域均取得增长。公司紧紧抓住手机产品国产国造机遇，成为重要客户的战略合作伙伴，实现了中高端手机 SOC46%的增长，同时夯实与手机终端 SOC 客户合作基础，份额不断提升，实现了 20%的增长；在手机周边领域，全面提升了与国内模拟头部超 5 家客户的合作，实现了近 40%的增长。公司依托工控与车规产品的技术优势，成为车载本土化封测主力，全面拓展车载功率器件、MCU 与智能座舱等产品，发挥品牌优势，扩大与海内外头部企业的合作，车载产品业绩同比激增超 200%。公司在 FCBGA 产品方面大力挖掘国内重要客户量产机会，从第二季度起月销售额呈阶梯式增长，实现 FC 全线增长 52%。此外，公司立足市场最新技术前沿，调整产品布局，积极推动 Chiplet 市场化应用。

2024 年，公司苏州工厂及槟城工厂通过采购融合、与总部采购互通，实现采购成本大幅下降；两家工厂协同总部共同推动多元化战略，成功实现一百多种材料本地化采购；苏州工厂全年申请 95 件专利和软著，创历史新高，总计授权专利 142 件。2024 年，公司在通富超威槟城成功布局先进封装业务，建设 Bumping、EFB 等生产线。此举精准契合国际大客户的经营战略，有效助力

公司在先进封装领域进一步提升市场份额。

问题 3：公司 2024 年有哪些技术升级？

回复：2024 年，公司在先进封装技术领域取得多项进展。SIP 业界最小器件量产并建立了电容背贴 SMT 和植球连线作业能力。基于玻璃基板（TGV）的先进芯片封装技术取得重要进展，成功通过阶段性可靠性测试。

2024 年，公司在成熟封测技术领域深耕精进，降本提质，进一步提升公司技术和产品的竞争力。完成 QFN 和 LQFP 车载品的考核并进入量产阶段。优化设计方案实现低成本 wettable flank。DRMOS 产品实现批量量产，提供了高散热和高可靠性的产品方案。TOLT 正面水冷产品开发完成可靠性考核，进入量产阶段。

问题 4：公司 2024 年的专利情况怎么样？

回复：截至 2024 年 12 月 31 日，累计申请 1,656 项专利，其中发明专利占比近 70%，累计授权专利突破 800 项，以自主知识产权矩阵赋能企业高质量发展。

问题 5：公司间接投资 AAMI 的进展如何？

回复：2024 年，公司与深圳市领先半导体发展有限公司签署了《合伙份额转让协议》，出资 2 亿元受让领先半导体持有的滁州广泰 31.90% 的合伙份额，以间接持有引线框架供应商 AAMI 股权；同年，公司与至正股份签署了《资产购买协议》，至正股份拟发行股份购买公司持有的滁州广泰出资额。2025 年 2 月 28 日，公司与马江涛签署了《合伙份额转让协议》，公司以自有资金出资 1,500 万元受让马江涛持有的嘉兴景曜 1.91% 的合伙份额，以间接持有 AAMI 股权。同日，公司与至正股份签署《资产购买协议之补充协议》，至正股份拟收购 AAMI 控制权，至正股份将向公司发行股份收购公司持有的滁州广泰和嘉兴景曜出资额。截至 2025 年 3 月 24 日至正股份已收到上海证券交易所出具的《关于受理深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）（2025）17 号）。上交所根据相关规定对其申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

问题 6：公司近期稼动率情况如何？

回复：公司稼动率会随着市场供需情况的变化而相应变化，具体的经营情况，敬请关注后续披露的公告。

	问题 7：介绍一下公司 2025 年资本开支计划？ 回复：公司及下属控制企业南通通富、合肥通富、通富通科、通富超威苏州及通富超威槟城等计划 2025 年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计 60 亿元。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 5 月 20 日